

指導教授

陳光辰 教授

參與學生

u870820 陳彥銘

u870829 張俊傑

摘 要

此專題主要是記錄民國90年七、八月實習於系格股份有限公司的過程與成果。

本專題的內容包括有：

0. 致謝詞
1. 前言
2. 國內IC封裝產業簡介
3. 系格公司封裝作業流程簡介
4. 成本分析專案
5. 產能規劃專案
6. 實習心得
7. 參考資料
8. 附錄

兩個月的實習期間，我們參與了成本分析與產能規劃等專案進行，實習期間中除了了解到一個公司運作情形、獲取了特別的實務經驗，也對大學所學的能力與知識做了複習與應用。

回目錄